

2. Les substrats utilisés

Le type de plaques utilisés est le **FR-4** de 1.6 mm d'épaisseur avec 35 micromètre de cuivre en simples et doubles faces.



NB: Si vous désirez développer vos cartes sur d'autres substrats hors mis le FR-4 (par exemple: CEM 1, bakelite , Rogers) vous pouvez nous fournir la plaque.

3. Développement et finitions

_La métallisation des trous des circuits imprimés pour assurer la continuité entre les deux faces se fait par méthode chimique.

_La méthode de projection sur résine photosensible est utilisée pour le développement professionnel des pistes de vos circuits imprimés avec une grandes résolution.

_Pour le prototypage nous réalisons le milling des pistes avec la machine CNC technique dite développent par fraisage.

